

## RJ45M S1D DE4N RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



RJ45 jeladó-aljzatok (mágneses) gigabitos alkalmazásokhoz (1000 base-T) integrált kompenzációval - aktívan együttműködik az induktív és kapacitív csatlakozásokkal, valamint helyet takarít meg a NYÁK-on.

A termékválaszték a következő kiviteli változatokat tartalmazza:

- 90°, fekvő (vízszintes) és 180°, álló (függőleges)
- felfelé reteszelő / lefelé reteszelő
- THT, THR vagy SMD forrasztási eljárások
- Különböző kiviteli változatok széles választéka, beépített LED-ekkel és az árnyékolás érintkező füleivel
- Átviteli sebesség 1 Gbit/s-ig
- Tálcán (TY) vagy tekercsen (feltekercselt szalag, RL)
- Kompatibilis a moduláris RJ45 csatlakozóval, az ANSI / TIA-1096-A és IEC 60603 szabványnak megfelelően.
- Átütési szilárdság  $\geq 1500$  V AC RMS (2250 V AC csúcsérték) az IEEE 802.3 szerint
- Átütési szilárdság  $\geq 1500$  V AC (csúcsérték) vagy  $\geq 1500$  V DC az IEC 60603 szerint
- Megfelelés az IEEE 802.3 követelményeinek (1000Base-T, 1 Gbps, IEEE 802.3ab vagy 100Base-Tx, 100 Mbps, IEEE 802.3u)

Tulajdonságok és előnyök:

- Bővített,  $-40$  °C és  $+85$  °C közti hőmérséklet-tartomány a maximális teljesítmény érdekében

- Megerősített aranyréteg ( $30 \mu\text{m}$ ) a megnövelt korrózió elleni védelem érdekében
- A legalább 0,3mm-es kiemelkedés tökéletes forrasztást eredményez.

## Általános rendelési adatok

Verzió	NYÁK dugaszoló csatlakozó, RJ45 jacks transformer, 10/100 MBit/s, SMD-forrasztott csatlakozás, 90°, Retesz opció: bottom, Shield tabs: 6 tabs, 30...80 $\mu\text{m}$ Ni / $\geq 30 \mu\text{m}$ Au, LED: Nem, Pólusszám: 8, Tape
Rendelési szám	<a href="#">2564450000</a>
Típus	RJ45M S1D DE4N RL
GTIN (EAN)	4050118572940
Qty.	220 Stück
Csomagolás	Tape

## RJ45M S1D DE4N RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	21,55 mm	Mélység (coll)	0,848 inch
Magasság	13,46 mm	Magasság (coll)	0,53 inch
Legalacsonyabb változat magassága	12,86 mm	Szélesség	16 mm
Szélesség (coll)	0,63 inch	Nettó tömeg	0,001 g

## Electrical properties

Névleges feszültség	125 V	Névleges áram	1,5 A
Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	1500 V DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1000 V DC

## Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 9T	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	II
Küszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 500	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Érintkező alapanyaga	Foszfor-bronz
Érintkező anyaga	Cu-ötvezet	Érintkező felület	Arany a nikkel felett
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C		

## Csomagolás

Csomagolás	Tape	VPE hosszúság	356 mm
VPE szélesség	351 mm	VPE magasság	129 mm
Dobos tekercs átmérője Ø (A)	330 mm	Felületi ellenállás	Rs = 10 <sup>9</sup> - 10 <sup>12</sup> Ω

## Rendszerspecifikációk

Csatlakozás típusa	SMT-forrasztott csatlakozás	Dugaszolási ciklusok	750
Egysíkúság:	100 μm	Felszerelés NYÁK-ra	SMD-forrasztott csatlakozás
Forrasztási eljárás	Reflow forrasztás, Kézi forrasztás	Forrasztótüske hossza (l)	0 mm
Forrasztótüske méretei	Nyolcszögletű	Forrasztótüskék száma pólusonként	1
Kimenő könyök	90°	LED	Nem
Osztás, inch (P)	0,05 "	Osztás, mm (P)	1,27 mm
Pólusszám	8	Retes opció	bottom
Shield tabs	6 tabs	Teljesítménykategória	10/100 MBit/s
Termékcsalád	OMNIMATE Data - RJ45 átalakító dugasz	Tolerance of solder pin position	± 0.1 mm
Védelmi osztály	IP20	Árnyékolás	Igen
Árnyékolás felülete	nikkelezett	Árnyékoló anyag	Sárgaréz
Átviteli sebesség	10/100 MBit/s		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9,1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

**RJ45M S1D DE4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Tanúsítványok**

ROHS

Megfelel

**Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Certificate of Compliance](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

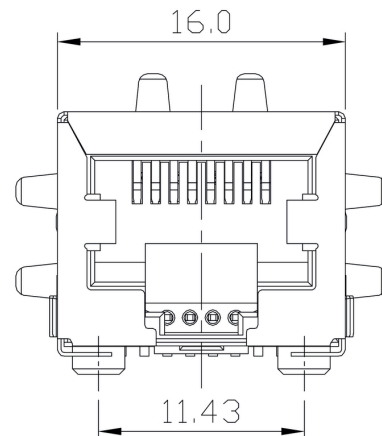
## RJ45M S1D DE4N RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

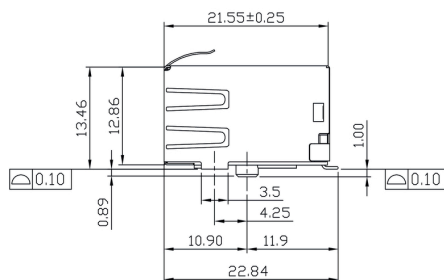
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

# Rajzok

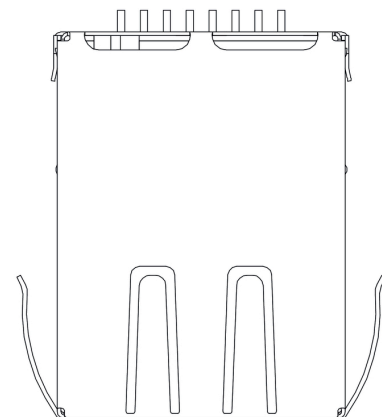
## Méretrajz



## Méretrajz

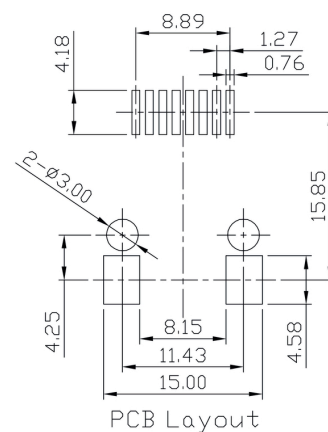


## Méretrajz



## Méretrajz

## NYÁK kivitel



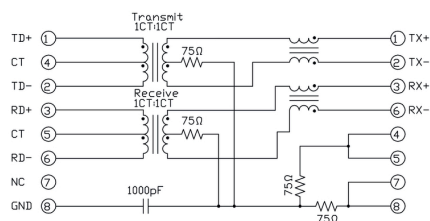
## RJ45M S1D DE4N RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rajzok

### Kapcsolási rajz



## RJ45M S1D DE4N RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Rajzok

RJ45	G1	R1	U3.2	E4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



## Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.